

2010年6月15日

ICパッケージ切断用の長寿命レジンボンドブレードを開発

三菱マテリアル株式会社(本社:東京都千代田区、取締役社長:井手明彦、資本金:1,194億円、以下「三菱マテリアル」)は、デジタル家電等に搭載される表面実装型ICパッケージ切断用レジンボンドブレード*註の長寿命化への要望に応えるため、新製品の開発に成功しました。

最近の電子機器の高密度・小型・軽量化に伴い、半導体・電子部品を高精度に切断する需要が増大しています。表面実装型ICパッケージを高精度切断するには、その上質な加工仕上り品位から一般にレジンボンドブレードが使用されています。しかしながら、昨今の電子デバイスの多電極化や加工精度ならびに要求寿命の向上により、更なるレジンボンドブレードの性能向上が求められていました。

今般、三菱マテリアルが新開発したレジンボンドブレード「NMR」は、樹脂粉末とダイヤモンド砥粒の混合原料中での分散状態を極限まで均一にさせる効果のある添加材を新たに採用することにより、ブレードの表面に突き出した個々のダイヤモンド砥粒が均等に刃先として作用する理想的な切断を実現し、電極の切断面をより平滑で高精度に加工することが可能となりました。また、均質に摩耗が進むことから、従来比1.4倍の耐摩耗性も実現できました。

今後は、本製品のシリーズ化とともに、ICパッケージ切断用以外の用途への適用に向けても開発を進めていく予定です。

2010年 6月 販売開始

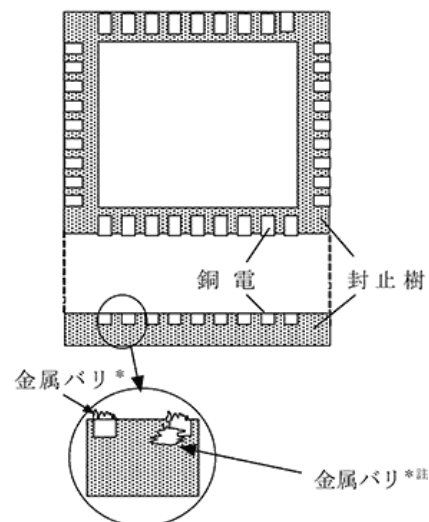
<主要製品仕様>

最小刃厚 : 0.2mm

最大径 : 60mm

* 註 ダイヤモンド砥粒を樹脂により封止・成型した精密回転切断刃

表面実装型ICパッケージの上面・立面図



* 註 ICパッケージの接続不良を引き起こす金属バリなどの発生しない高精度で平滑な切断が求められる。

新開発レジンボンドブレード「NMR」の対磨耗性能

